

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2026-032

芯联集成电路制造股份有限公司

关于公司股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“芯联集成”或“公司”）股东绍兴日芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“日芯锐”）持有公司股份 202,806,900 股，占公司总股本的 2.42%。

● 日芯锐本次解除质押股份数量为 110,000,000 股。解除质押后，日芯锐累计质押股份数量为 80,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 39.45%。

一、本次股份解质押基本情况

公司近日接到股东日芯锐通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押。具体情况如下：

单位：股

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股数（股）	本次解除质押股数占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
日芯锐	否	90,000,000	44.38%	1.07%	2024年4月25日	2026年6月29日	交银国际信托有限公司
		20,000,000	9.86%	0.24%	2024年9月10日	2026年6月29日	交银国际信托有限公司
合计	/	110,000,000	54.24%	1.31%	/	/	/

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，日芯锐及其一致行动人绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有

限合伙) (以下简称“硅芯锐”) 累计质押股份情况如下:

单位: 股

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前累计质押数量	本次解除质押后累计质押数量	本次解除质押后累计质押数量占其所持股份比例	本次解除质押后累计质押数量占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
日芯锐	202,806,900	2.41935%	190,000,000	80,000,000	39.45%	0.95%	0	0	0	0
硅芯锐	216,327,300	2.58064%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	419,134,200	4.99999%	190,000,000	80,000,000	19.09%	0.95%	0	0	0	0

上述质押事项如若出现其他重大变动情况, 公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年7月1日